# 300GHz 帯無線通信と超高周波 CMOS 集積回路の基礎 Fundamentals of 300 GHz Wireless Communications and Ultrahigh Frequency CMOS Integrated Circuits

# 藤島 実

## Minoru Fujishima

## 広島大学大学院先進理工系科学研究科

概要

44GHzの連続した周波数帯域を利用可能な 300GHz 帯は、これまでの無線通信と比べて圧倒的に高い伝送レートを実現できる可能性を秘めている。本講演では、この 300GHz 帯通信とそれを実現する CMOS 集積回路の概要を説明する。

## Abstract

The 300 GHz band, which is available in the continuous frequency band of 44 GHz, is a better alternative to previous wireless communications. It has the potential to achieve a dramatically high transmission rate. In this presentation, I will give an outline of the 300 GHz band communication and the CMOS integrated circuit to realize it.



図1 有線通信と無線通信のデータレートの推移[1]

有線通信と無線通信のデータレートは年々上昇し ている(図1)。特に無線通信のデータレートの上昇 が著しく、これまでに無線通信の最大データレート が 100Gb/s を超えることが発表されている[2]。この ままデータレートが上昇していけば、無線通信のデ ータレートが有線通信に比べて劣る時代はすぐに終 わるだろう。無線通信のデータレートが急上昇して いる理由の一つに、より高いキャリア周波数を使用 して使用する周波数帯の拡大がある。これまでも、 より高い周波数の開発によってデータレートは向上 してきた。しかし、周波数帯域の拡大は、ベースバ ンドの周波数帯域の拡大にもつながる(図2)。最終 的には、ベースバンドのデータレートは有線のデー タレートと同じになり、ベースバンドのデータレー トは有線のデータレートと同じになる。



図2 無線通信のデータレートの向上は、より高い搬送波を使用し、電波の周波数帯域を増加させること によって達成されてきた。しかし、周波数帯域の増加は同時にベースバンドの帯域幅を増加させること になり、これは結局のところ有線通信と同様の技術 的な制限となる。

広い周波数帯域を利用するのに適していると考え られるのが1テラヘルツ(THz)を中心とするテラヘル ツと呼ばれる周波数帯域である。このテラヘルツの 中で低周波数域となる 300GHz 帯が次世代無線通信 用周波数帯域として注目されている(図 3)。図 4 に 300GHz 近辺の周波数割り当てを示す。252GHz から 275GHz はこれまで陸上移動業務と固定業務の無線 通信に割り当てられていた。275GHz 以上はこれまで 周波数割り当てがなされていなかったが、WRC2019 にて275GHz から296GHz が無線通信用途として特定 された[3]。これらを合わせることにより 44GHz の周 波数帯域が無線通信に利用できる。



図3波長と周波数による電磁波の分類。テラヘルツは光と電波の中間に位置する1THz(テラヘルツ)前後の周波数帯である。



図 4 300GHz 近辺の電波の割り当て状況。252GHz から 275GHz は陸上移動業務と固定業務の無線通信用 に割り当てられている。WRC2019 において 275GHz から 296GHz が無線通信用途として特定された。こ れらを合わせると 44GHz の周波数帯域が無線通信に 利用できるようになる。

300GHz 帯に対して IEEE 802.15.3d では 252.72GHz から 321.84GHz までのチャネル割り当てが提案され た[4](図 5)。60GHz 帯と同様チャネルあたり 2.16GHz の周波数帯域を割り当てると 32 チャネルを割り当て ることができる。ただし、296GHz 以上の周波数帯域 では一部通信用途として特定されていない周波数帯 域を含んでいる。我々は、この中のチャネル 66 の周 波数帯域を用いる CMOS トランシーバを世界で初め て実現した。次の章ではこのトランシーバについて 解説する。そして、CMOS トランシーバを含む 300GHz 帯通信の未来について考察してみたい。



図 5 252.72GHz から 321.84GHz までの周波数帯域に 対するチャネル割り当てが IEEE 802.15.3d により提 案された。ただし、296GHz 以上の周波数帯域は一部 通信用途として特定されていない。

2. 300GHz 帯 CMOS ワンチップトランシーバ



図 6 300GHz 帯 CMOS トランシーバでは 300GHz 帯 の増幅器および局部発振器を実現することができな い。



図 7 300GHz 帯 CMOS 送信器と受信器のブロック図

300GHz帯CMOSトランシーバを実現するうえで、 一番の課題は、CMOS 集積回路における NMOSFET のユニティゲイン周波数(電力整合されている条件 で電力利得が1になる周波数)が300GHz以下ある いは300GHz付近にとどまることである。そのため、 300GHz帯増幅器や300GHz帯局部発信回路を実現す ることが困難である。そのため、図6に示すように 通常のトランシーバに用いられる電力増幅器や低雑 音増幅器を用いることができない。また、搬送波生 成も逓倍器を用いる必要がある。

そのため、電力増幅器のない送信器と低雑音増幅 器のない受信器を構成する必要がある(図 7)。300GHz 帯 CMOS 送信器では、電力増幅器が省略されている ために、300GHz帯信号を生成するミキサが最終段に 用いられる[5]。ひとつのミキサの生成する出力電力 は限られるために、無線通信に必要となる電力を生 成するために、最終段ミキサの出力を並列結合する。 最終段ミキサを並列接続するために、1入力1出力で ある 2 逓倍器(ダブラ)をミキサとして最終段に用い る。送信器ではヘテロダインアーキテクチャが用い られる。初段のミキサでは 150GHz 近辺の変調され た中間周波数(IF)信号に加え局部発振(LO)信号が出 力される。両者は同一周波数帯のために、ひとつの 信号線に重畳されて同時に増幅器で増幅される。増 幅された LO 信号と IF 信号はダブラ(ミキサ)で2乗 される。あるミキサには( $v_{LO} + v_{IF}$ )信号が入力され、 別のミキサには( $v_{LO} - v_{IF}$ )信号が入力される。ミキ サの出力にはそれぞれ $(v_{LO} + v_{IF})^2 \geq (v_{LO} - v_{IF})^2 m$ 出力される。2つの信号の差動成分をバランで得るこ とにより、 $(v_{LO} + v_{IF})^2 - (v_{LO} - v_{IF})^2 = 4v_{LO} \cdot v_{IF}$ いうミキサの所望波だけを得ることができる。



図 8 300GHz 帯 CMOS ワンチップトランシーバのブ ロック図。送信器と受信器を統合するためにラット レースバランの派生であるダブルラットレース回路 を用いた。

一方、300GHz 帯 CMOS 受信器では低雑音増幅器 のないミキサファーストアーキテクチャを用いるこ とになる[6]。この場合、ダウンコンバージョンミキ サの損失と雑音指数が受信器の性能を決めるために、 両者を小さくしなければならない。周波数が高くな るとサブハーモニックの LO 信号を用いるハーモニ ックミキサを用いられる場合が多いが、基本波ミキ サと比較しハーモニックミキサは変換損が大きく受 信器の性能が劣化する。変換損は基本波ミキサの方 がハーモニックミキサよりも小さくすることができ る。ただし、基本波ミキサの変換損を小さくするた めには十分に大きな電力の LO 信号を与える必要が ある。そこで、十分に大きな電力の LO 信号を生成 するために、LO を生成する 2 逓倍器の出力を並列に 接続することにより電力結合している。

これらの送信器および受信器をワンチップとする ためには、両者を統合する必要がある。300GHz帯ワ ンチップトランシーバのブロック図を図8に示す[7]。 IEEE 802.15.3d のチャネル 66 を用いるために RF 信 号はおよそ 266GHz となる。ラットレース回路には 差動出力ポートと同相出力ポートが備わっている。 そこで、送信モードで用いる場合には、送信(TX)べ ースバンド(BB)に変調信号を入力し、133 GHz (=266/2 GHz)のLO信号を用いて初段ミキサでアップ コンバージョンを行う。アップコンバージョンされ た信号の中で変調された中間周波数信号(v<sub>IF</sub>)は2つ の信号経路に互いに逆相で局部発信信号(v<sub>L0</sub>)に重 畳する。ダブラ(ミキサ)の出力に接続されたラッ トレース回路の差動信号ポートから所望の信号を得 る。一方、受信モードでは TXBB 信号をオフにする。 すると、初段ミキサは局部発信信号(v<sub>L0</sub>)だけが出力 される。ダブラの出力では 266GHz の(v<sub>L0</sub>)信号が生

成される。複数のダブラの出力をラットレース回路 の同相信号ポートから取り出すことにより、ダブラ の出力を電力結合することができる。出力電力が増 強された LO 信号を基本波ミキサに供給することに より基本波ミキサの変換損を抑えることが可能とな る。



図 9 300GHz 帯 CMOS ワンチップトランシーバのチ ップ写真

300GHz 帯ワンチップトランシーバは 40nm CMOS プロセスを用いて試作した。チップ写真を図 9 に示 す。チップサイズは 2.3mm×4.9mm である。300GHz 帯ワンチップトランシーバ回路を用いた通信実験の 様子を図 10 に示す。送信用基板と受信用基板は、 CMOS 集積回路は同一であるが、それぞれ送信モー ドと受信モードを実現する基板上に実装されている。 基板に実装された CMOS 集積回路は導波管プローブ を用いて 300GHz 帯の信号の入出力を行った。導波 管プローブには 24dBi の標準ゲインホーンアンテナ が装着されている。図 10 には主要性能と 80Gb/s 時 のコンステレーションとスペクトラムを示している。 消費電力は送受信合わせて 1.8W、最大出力電力は -1.6dBm であった。



図 10 ワンチップ CMOS トランシーバの通信実験の ブロック図と主要性能

### 3. 広帯域無線通信の課題

300GHz 帯無線通信回路は、2 章で示したように CMOS 集積回路を用いて実現されている。もし搬送 波周波数がこのまま増加し、ベースバンド回路の帯 域が広がり続ければ通信速度は無限大とすることが できるのであろうか。

理論的な通信容量*C*を与えるシャノン・ハートレーの定理によると

$$C = B \log_2\left(1 + \frac{S}{N}\right) \tag{1}$$

で与えられる。ここでBは周波数帯域、Sは信号電力、 Nは雑音電力である。 無線通信でのSは受信電力Prと なる。Nは

$$N = kTB \cdot N$$

で与えられる。ただし、kはボルツマン定数、Tは絶対温度、NFは雑音指数である。(2)を(1)に代入することにより

(2)

$$C = B \log_2 \left( 1 + \frac{P_{\rm r}}{kTB \cdot \rm NF} \right) \tag{3}$$

を得る。通常の無線通信では、SはNに比べ十分に大きくなるため、 $B \ll P_r/(kT \cdot NF)$ となる。このとき、(3)は

$$C \simeq B\left(\log_2 \frac{P_r}{B} - \log_2(kT \cdot NF)\right)$$
 (4)

となる。log の中にも含まれるBは、カッコの外にあるBに比べ変化が小さいために、CはBに対してほぼ比例して増加する。一方、SがNに比べ小さくなる、





図 11 受信電力P<sub>r</sub>を変えたときの周波数帯域の変化 によるチャネル容量の変化の様子。この計算では、 *T* = 290K,NF = 20dBとした。チャネル容量は周波数 帯域を広げると飽和する。



図 12 受信電力を変えたときの周波数帯域の変化に よる信号雑音電力比(SNR)の変化の様子。QPSK, 16QAM, 64QAM を復調するために必要な SNR を赤 線で示す。T = 290K, NF = 20dBとした。

図 11 に受信電力Prを変えたときの周波数帯域の変 化によるチャネル容量の変化の様子を示す。広帯域 特性を活かしチャネル容量を増加させるためには受 信電力を増大し飽和チャネル容量を増加させること が不可欠であることがわかる。

通常の無線通信ではSはNに比べ十分に大きい。図 12には、受信電力を変えたときの周波数帯域の変化 による信号雑音電力比 (SNR)の変化の様子を示す。 25GHz の周波数帯域を実現するには、QPSK であっ ても0.1µW以上の受信電力が必要となる。100GHz 級の周波数帯域を実現するには1µW(-30dBm)近くの受信電力が必要となる。通常用いられるマイクロ波の通信では1nW(-60dBm)以下の受信電力が用いられることに比べると、広帯域通信を実現するためには、搬送波周波数とは無関係にけた違いに大きな受信電力が必要となることがわかる。

一方、搬送波周波数と受信電力の関係はどのよう になっているのだろうか。受信電力P<sub>r</sub>はフリスの公 式により

$$P_r = P_t G_t G_r \left(\frac{\lambda}{4\pi d}\right)^2 \tag{6}$$

で与えられる。ただし、 $P_t$ は送信電力、 $G_t \ge G_r$ はそ れぞれ送信アンテナと受信アンテナの利得、 $\lambda$ は波長、 dは通信距離である。(6)によると、アンテナ利得が一 定であれば、 $P_r$ は $\lambda^2$ に比例して小さくなる。すなわち 搬送波周波数が高くなると $P_r$ は小さくなる。このた め、搬送波周波数が高いことは遠距離通信に向いて いないと考えられることが多い。一方で、アンテナ 利得 $G_r$ は

$$G_I = \frac{4\pi}{\lambda^2} A_e \tag{7}$$

で与えられる。ただし、 $A_e$ はアンテナの実効面積である。(7)を(6)の $G_t$ と $G_r$ に適用することにより、

$$P_r = P_t \frac{A_t A_r}{(\lambda d)^2} \tag{8}$$

を得る。ただし、 $A_t$ と $A_r$ はそれぞれ送信アンテナと 受信アンテナの実効面積である。(8)によると、実効 アンテナ面積が一定であればPrはλ<sup>2</sup>に反比例して大 きくなる。すなわち搬送波周波数が高くなるとPrは 大きくなる。したがって、テラヘルツ通信のように 搬送波周波数が極めて高い通信であっても、マイク ロ波で用いられているのと同様の大きさのアンテナ を用いれば十分に長距離を伝送することも可能とい える。もちろん、アンテナの実効面積が一定である ということは、(7)よりアンテナ利得は<sup>2</sup>に反比例し て増加するために搬送波周波数が増加するにつれビ ームが絞られることになる。広帯域通信を実現する ためには搬送波周波数を増加させなければならない が、搬送波周波数を増加させるとビームを絞ること が要求されることになる。広範囲に電力を拡散する 放送型の通信を実現することは困難である。

ビームを絞ることが必然であれば、その方向を正 確に制御する必要がある。ビーム制御を電子的に行 う方法にフェーズドアレイアンテナがある。フェー ズドアレイアンテナではアンテナ素子間の位相制御 によりビームの方向を制御する。それぞれのアンテ ナ素子に送信器を接続するとすれば、アンテナの指 向性が高まるだけでなく、空間合成された送信器の 出力電力も増大する。CMOS トランシーバではトラ ンジスタの高周波性能が 300GHz 帯の増幅器を実現 させるために十分でないことからひとつの送信器で 大きな出力電力を得ることが難しい。しかし、フェ ーズドアレイアンテナで空間合成すればその欠点を 克服することができる。また、フェーズドアレイア ンテナでビーム指向性を制御するにはデジタル回路 による制御が必要となるが、デジタル回路の実装に は CMOS 集積回路が適している。図 13 にはフェー ズドアレイアンテナの素子数を変えた場合の空間合 成された出力電力とアンテナ利得を示している。た とえば 16384 素子を並列に接続する場合、送信器単 体の出力電力が 1mW であったとしても空間合成さ れた出力電力は 16W にも達する。アンテナ利得は 50dBiとなる。このような高出力かつ高アンテナ利得 が実現できるとすれば、この後考察するように、宇 宙への通信に応用することも夢ではない。たとえこ のような高素子数フェーズドアレイアンテナであっ ても、アンテナ全体のサイズは(1波長間隔で並べる と仮定すれば)わずか 13cm×13cm しかなく、決し て巨大なシステムではない。このことはテラヘルツ 通信に対する CMOS 集積回路の適性を示唆している のではないだろうか。



フェーズドアレイアンテナ

	出力電力	アンテナ利得
4並列(2x2)	6dBm(4mW)	13dBi
64並列 (8x8)	18dBm(64mW)	25dBi
1024並列 (32x32)	30dBm(1W)	38dBi
16384並列 (128x128)	42dBm(16W)	50dBi

図 13 フェーズドアレイアンテナを用いた場合の素 子数と出力電力、アンテナ利得の関係。出力 0dBm、 アンテナ利得 7dBiをもつ送信器を並列に用いる場合 の試算。

#### 4.300GHz 帯通信の特徴と応用

テラヘルツ通信が実用化されたときの応用は、通 信距離を含む通信特性に依存する。そこで、まずそ の特性について考察し、それに適した応用について 考えてみる。



図 14 30GHz から 3THz における電波の大気減衰。 60GHz, 183GHz, 325GHz において距離 1km で大気減 衰が 10dB を超えるピークがあるほか、351GHz 以上 ではすべての周波数で大気減衰が 10dB/km を超える。 それ以外の周波数では、距離 1km では大気減衰の影 響はあまり大きくない。

#### 4.1 テラヘルツ帯通信の特性

テラヘルツ帯は大気減衰が大きく近距離通信に限 定されると思われるかもしれない。実際のところ大 気減衰の影響はどれくらいであろうか。図 14 には 30GHz から 3THz までの大気減衰を示す[8,9]。大気 減衰が 10dB 以下であれば、その影響は比較的小さい。 一方で、たとえば 1km での大気減衰が 10dB を超え ると、キロメートル級の通信が困難になる。このよ うな周波数は、60GHz、183 GHz、325GHz と 351 GHz 以上である。これらの周波数を除けば、少なくとも 1km 程度の中距離通信には大気減衰の影響は比較的 小さい。252GHz から 296GHz にかけて大気減衰が 10dB となる距離が 2km を超える周波数帯が存在す る。これが、300GHz 帯が通信用途として注目される 一つの理由となりうる。

## 4.2 300GHz 帯通信の応用例

300GHz 帯は光通信と同等のデータレートが実現 できることから、IEEE 802.15.3d の PAR (Project Application Request)には、光通信を無線通信に置き換 える無線バックホール/フロントホール、機器内無 線通信、データセンター用ポイント間切り替え接続 の他、キオスクダウンロードのような近接無線応用 が示されている[10]。

一方で、遅延時間が小さいことは光通信に対する 無線通信の利点のひとつである。電磁波の伝搬速度 は、媒質の誘電率の平方根に反比例する。このため、 大気の電磁波の伝搬速度は光ファイバに比べおよそ 50%速く、無線通信はリアルタイム応用に優れてい る。この性質を利用し、ニューヨークとシカゴ間に2 億5000万ドルを費やして高速取引専用のマイクロ波 回線が敷かれた[11]。テラヘルツ通信では、光通信と 同等の通信容量を低遅延で伝送することが可能であ る。8Kのフル規格映像を非圧縮で伝送する場合、最 大毎秒 144 ギガビットの通信容量が必要となる。デ ジタル変調のロールオフ係数を 0.22 に設定すると 44GHzの帯域があれば、16 QAMで毎秒 144 ギガビ ットの無線通信が可能となる。この周波数帯域は 300GHz 帯であれば割当可能である。たとえば、8K カメラを搭載したドローンを用いれば、迅速に災害 箇所や遭難場所の状況をリアルタイムで観察するこ とも可能となる。これは、従来の無線通信や光通信 では実現できない新しい応用となる。

#### 4.3 テラヘルツ帯通信の宇宙応用

将来、大出力のテラヘルツ送信器と高利得アンテ ナが利用できるようになれば、アンテナ実効面積が 一定の条件で周波数が高いほど受信電力が増大する テラヘルツ通信は、大気減衰の無い宇宙には有望な 応用になると考えられる。300GHz帯であれば 1.2m ほどのアンテナ径で 70dBiのアンテナ利得が得られ る。利得Gのアンテナが距離d離れた位置につくるビ ームの直径φは、周波数によらず

$$\phi \simeq \frac{4a}{\sqrt{G}}$$
 (5)

で与えられる。70dBiのアンテナを用いると1000km 先のビームの直径は1.3kmとなる。レーザー光より もビーム径が広がるテラヘルツ通信は、アンテナの 位置制御の要件を緩和するのに役立つ。さらに、大 気減衰がない宇宙でのテラヘルツ通信では300GHz 帯以上の周波数帯も活用可能である。およそ標高 5000m で大気密度は平地の半分になるため、降雨減 衰のない砂漠であれば理論上は地上と宇宙間を安定 して高速通信できる可能性がある。

社会課題の解決にテラヘルツ通信を活用できない だろうか.たとえば、実社会の様々な現象を大規模 かつ正確にシミュレーションするために、スーパー コンピュータの性能向上は欠かせない.スーパーコ ンピュータの性能向上をこれからも期待するなら、 解決しておかなければならない課題は何であろうか. スーパーコンピュータの演算性能は指数関数的に向 上しており、およそ 10 年で 1000 倍となっている. 現在、1 秒間に 100 京回(10<sup>18</sup>回)浮動小数点演算を行 うことのできるエクサスケールコンピュータ富岳は 2020 年に稼働が始まった.もし、この先も演算速度 の向上が続くとすれば 2030 年には 1 秒間に 10 垓回 (10<sup>21</sup> 回)という途方もない速度で浮動小数点演算を 行うことのできるゼッタスケールコンピュータが誕 生することになる. ここでひとつ問題となるのが消 費電力である. 富岳の消費電力は 28MW といわれて いる[12]. 一方で、演算能力が 1000 倍高いゼッタス ケールコンピュータでは一層の低消費電力化が進め られるだろうが、その消費電力は GW 級になるので はなかろうか.1GWの消費電力はおよそ原子力発電 機1機に相当する. このようなスーパーコンピュー タの膨大な消費電力を賄いつつ持続可能な社会を維 持ためにはどうすればよいのであろうか. 安定した 再生可能エネルギーの候補のひとつとして、静止軌 道衛星上の 2.5km 四方の太陽パネルを用いる宇宙太 陽光発電の研究が進められている[13]. この太陽光パ ネルは1GWを発電できると言われている.宇宙太陽 光発電で作られる電気はマイクロ波を用いて地上に 送電される. この送電効率の目標は 50%となってい る.しかし、スーパーコンピュータを宇宙に設置し、 宇宙太陽光で発電された電力をその場で消費すれば, 送電損失なく電力を有効に活用できる[14]. 光ファイ バを敷設することのできない宇宙のスーパーコンピ ュータに対する大容量のデータ交換が必要となるが、 ここに超高速テラヘルツ通信を用いることは可能で あろう.

必要な送信電力とアンテナ径



図 15 300GHz 帯通信を宇宙に用いるときに必要となる性能の試算結果. 将来, テラヘルツ通信の送信電力が大きくなれば, 宇宙に向けた広帯域通信リンクを形成することも可能になる.

また、1 兆個を超える膨大なセンサで実社会をモ

ニタし、その情報を人工知能で活用する時代となり つつある.センサから得られる情報はそのまま蓄え られるわけではないものの、蓄えられるデータ量は 指数関数的に増大する一方である.その一方で時間 がたってアクセス頻度が低くなるコールドデータも 増大する一方である.コールドデータはアクセス頻 度が低いために、アクセス速度は重要ではない.遅 いアクセスを許容するなら、コールドストレージデ ータセンタを地球以外の、例えば月面に建設するこ とも可能であろう[14].月までの光の伝搬時間は 1.3 秒である.したがって、アクセス速度は往復で 3 秒 程度となるが、月面の有効活用のひとつとして考え られるのではないだろうか.

さらに,現在火星への有人探査と人類の移住が検 討されている[15].火星に移住した人類が地上と通信 する手段は無線に限られる.100 Gb/s のデータレー トで情報が送り続けられれば,1日で1ペタバイトを 伝送することができる.火星が地球から最も遠くな ると光でも伝搬するのに21分かかるためリアルタイ ムにはならないが,テラヘルツ通信を使えば地球と 火星で大容量の情報を交換することが可能である.

静止軌道,月,火星にテラヘルツ通信を実現する ために必要となる性能を図15に試算した.すぐに実 現できる技術とは言えないかもしれないが,人類の 持続的な発展のために挑戦する価値のある研究課題 となるのではないだろうか.

#### 5.まとめ

300GHz 帯は大気減衰が比較的小さく、44GHz の広 い利用可能な周波数帯域である。有線通信と同等の データレートを実現できる 300GHz 帯無線通信は、 2020 年以降の宇宙計画にも影響を与える可能性を秘 めている。また、商用の光通信用 CMOS 超高速ベー スバンド信号処理チップとテラヘルツフロントエン ドと組み合わせれば,近い将来テラヘルツ通信は実 用化されるであろう。ミリ波帯よりも高精度にビー ム制御を行うことができれば遠距離通信も夢物語で はなくなるであろう。互いの位置情報を共有する技 術の進展などで現在の課題が克服され、テラヘルツ 通信が社会に役立つ日が訪れることを願っている。

謝辞 本研究開発は、総務省の「電波資源拡大のた めの研究開発(JPJ000254)」によって実施した成果 を含む。情報通信研究機構、パナソニック、ザイン エレクトロニクス、名古屋工業大学、東京理科大学、 広島大学の関係各位に深謝する。

- [1] T. Kürne, IEEE 802.15-10-0320-02-0000-Tutorial\_Igthz
- [2] K. K. Tokgoz et al., "A 120Gb/s 16QAM CMOS millimeter-wave wireless transceiver," 2018 IEEE International Solid - State Circuits Conference - (ISSCC), San Francisco, CA, 2018, pp. 168-170, 2018.
- [3] "Sharing and compatibility studies between land-mobile, fixed and passive services in the frequency range 275-450 GHz," Report ITU-R SM.2450-0, June 2019.
- [4] IEEE Standard for High Data RateWireless Multi-Media Networks, Amendment 2: 100 Gb/sWireless Switched Point-to-Point Physical Layer, IEEE Computer Society sponsored by the LAN/MAN Standards Committee.
- [5] K. Takano, S. Amakawa, K. Katayama, S. Hara, R. Dong, A. Kasamatsu, I. Hosako, K. Mizuno, K. Takahashi, T. Yoshida, M. Fujishima, "A 105Gb/s 300GHz CMOS transmitter," 2017 IEEE International Solid-State Circuits Conference (ISSCC), pp. 308-309, Feb. 2017.
- [6] S. Hara, K. Katayama, K. Takano, R. Dong, I. Watanabe, N. Sekine, A. Kasamatsu, T. Yoshida, S. Amakawa, M. Fujishima, "A 32 Gbit/s 16QAM CMOS receiver in 300 GHz band," 2017 IEEE International Microwave Symposium (IMS2017), pp. 1-4 (8 June 2017)
- [7] S. Lee et al., "An 80-Gb/s 300-GHz-Band Single-Chip CMOS Transceiver," *IEEE Journal of Solid-State Circuits*, vol. 54, no. 12, pp. 3577-3588, Dec. 2019.
- [8] P.Baron, J.Mendrok, Y.Kasai, S.Ochiai, T.Seta, K.Sagi, K.Suzuki, H.Sagawa, and J.Urban "AMATERASU: Model for Atmospheric TeraHertz Radiation Analysis and Simulation," Journal of the National Institute of Information and Communications Technology, vol. 55, no. 1, pp. 109-121, 2008.
- [9] Recommendation ITU-R P.676-11, "Attenuation by atmospheric gases," P Series Radiowave propagationCookson, Sep. 2016.
- [10] http://www.ieee802.org/PARs/2015\_11/15-15-0682-01-003d-3d-par-change.pdf
- [11] "Time is Money When It Comes to Microwaves," FT Magazine, May 10, 2013.
- [12] https://www.top500.org/system/179807/
- [13] M. Mori, H. Kagawa, and Y. Saito, "Summary of studies on space solar power systems of Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)," Acta Astronautica, vol.59, no.1–5, pp.132– 138, 2006.
- [14] M. Fujishima, S. Amakawa, "Integrated-Circuit Approaches to THz Communications: Challenges, Advances, and Future Prospects," IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences, vol. 100, no. 2, pp. 516-523, 2017.
- [15] G. Daines, "NASA's Journey to Mars." NASA, www.nasa.gov/content/nasas-journey-to-mars. 2015.

#### 著者紹介

昭 63 東京大・工・電気卒.平5 同大学院博士課程了. 同年東京大・工・電子工学科助手.以来,非線形回 路、量子回路、ミリ波回路の研究に従事.平21 広島 大・先端物質科学研究科教授.令2より広島大・先 進理工系科学研究科教授.工博.IEEE,電子情報通 信学会、応用物理学会会員.平23年度エレクトロニ クスソサイエティ賞.電子情報通信学会フェロー.